

# 新中長期経営計画 <バリューアッププラン>

アルバックグループは、外部環境の変化等により、前3カ年中期経営計画(2024年6月期~2026年6月期)を1年前倒して終了し、2026年6月期を初年度とする新中長期経営計画「バリューアッププラン」を始動しました。本計画では、経営資源の最適化と、半導体電子中心の事業ポートフォリオへの見直しを進めることで、持続的な成長と高収益性の実現を目指します。

## 基本方針・目指す姿

半導体電子中心の  
事業ポートフォリオの  
選択と集中

### 成長戦略

半導体電子への注力加速

事業間シナジーを活用した新たな  
半導体電子関連ビジネスの創出

M&A等を活用したビジネス拡大

### 事業改革(2年間で完遂)

低採算事業等の縮小撤退

グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化

人件費・販管費等の適正化による固定費削減

### 生産改革

生産拠点の生産効率UP

モジュラーデザインによる収益性改

31/6期  
中長期財務目標

営業利益 **790**億円  
営業利益率 **22%**

約 **1,100**億円 UP

31/6期までの連結売上高増加額

**5.5%** UP

28/6期までの営業利益率改善

**12%** UP

31/6期までの対象装置事業における営業利益率改善

## 中長期財務目標

項目	2025/6期 通期実績	2028/6期 中間目標	2031/6期 目標
売上高 (CAGR) <small>半導体電子関連ビジネス*2</small>	2,512億円	2,600億円 <small>(事業改革による縮小撤退考慮後)</small>	3,600億円 <small>(CAGR 12%)*1 (CAGR 17%)</small>
半導体電子関連ビジネス 売上高構成比	36%	45%	60%以上
営業利益	265億円	390億円	790億円
営業利益率 <small>半導体電子関連ビジネス</small>	10.6% 11.6%	15% 19%	22% 25%
ROE	7.5%	10%	16%

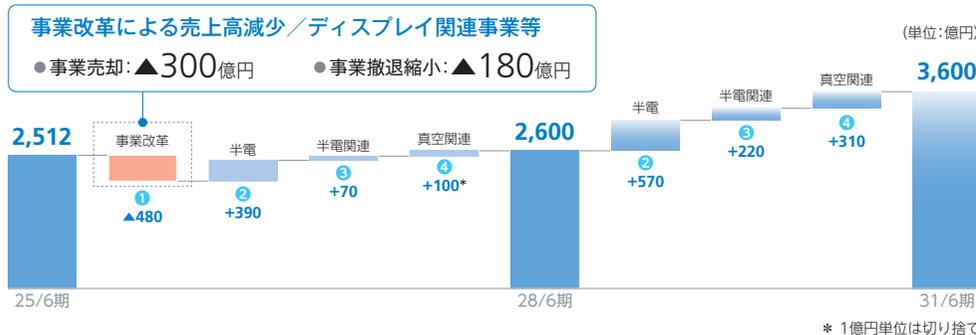
\*1 事業改革後の想定売上高をベースに計算  
\*2 管理会計に基づく数値 半導体電子事業及び関連事業

## 目標達成に向けた道筋

2028年6月期までに、事業改革による売上高の減少を上回る半導体電子事業等の成長を推進し、営業利益率の着実な改善を実現する。

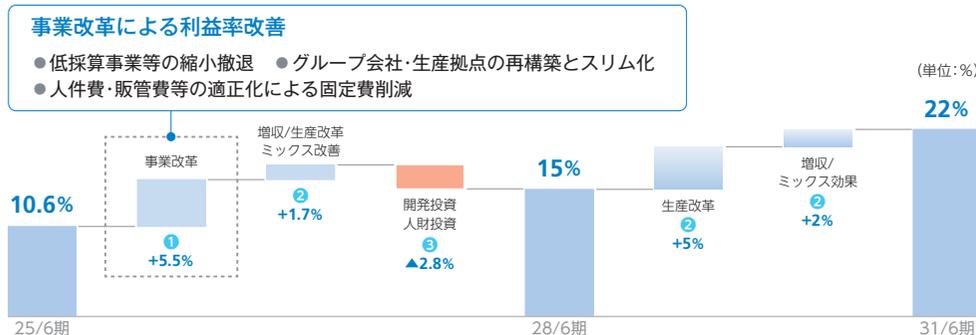
### 売上高増減要因

- ① 低採算事業等の縮小撤退等による売上高減少
- ② 半導体電子ビジネスの売上高増加
- ③ 半導体電子関連ビジネスの売上高増加
- ④ 真空関連ビジネスの売上高増加



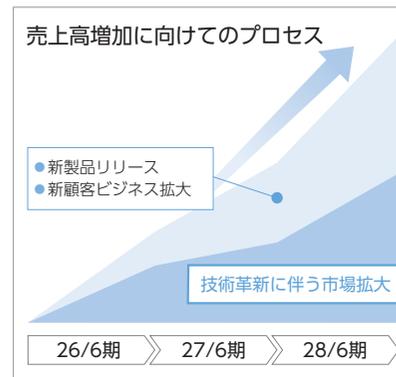
### 営業利益率増減要因

- ① 事業改革による利益率改善
- ② 生産改革・ミックス改善・増収による営業利益増加
- ③ 2028年6月期以降の成長に向けた製品開発投資・人財投資等



## 2028年6月期にかけての売上高増加要因

既存ビジネスをベースに技術革新に伴う市場拡大と顧客技術ロードマップに連動した新製品リリースなどにより、事業改革に伴う売上高減少を上回る半導体電子事業等の成長を目指す。



### 28/6期にかけての売上高増加要因

② 半導体電子 **+390** 億円

- メモリ  
HBM関連投資活発化+新顧客・新工程参入
- ロジック  
ハードマスク工程展開+金属膜工程参入
- パワーデバイス  
BinchSiC投資本格化+GaN投資開始

● 各種電子デバイス  
パッケージングビジネス活況+新顧客・新工程参入

③ 半導体電子関連 **+70** 億円

- 表面分析装置  
分析装置シェア堅持+半導体検査装置ビジネス参入
- マテリアル(半導体)  
半導体ビジネス活況+競争優位製品で拡大

④ 真空関連 **+100** 億円\*

- コンポーネント  
半導体電子市場向け新製品リリースによるビジネス拡大
- バッテリー等  
リチウム電池の安全性向上へ両面蒸着膜採用進展
- リークテスト  
データセンター向け冷却システム等、多用途展開拡大

